### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-317629

(43)Date of publication of application: 21.11.2000

(51)Int.CI.

B23K 3/02 B23K 1/018 C22C 19/03 C22C 38/00 C22C 38/08

(21)Application number : 11-128154

(71)Applicant: HAKKO KK

(22)Date of filing:

10.05.1999

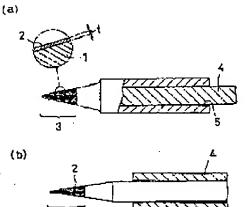
(72)Inventor: KAMIYA KOJI

#### (54) IRON TIP FOR SOLDERING IRON

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an iron tip for soldering iron which can correspond to a lead-free solder and which prevents the oxidation of the iron tip at high temp, and the adhesive wettability of the solder caused by the oxidation.

SOLUTION: An iron-nickel alloy plating is applied to the surface of the copper or the copper alloy-made base body 1 of the iron tip. Then, the hardness of this iron-nickel alloy plating film 2 is ≤ about 300 micro Vickers hardness. Further, the layer thickness of the alloy plating layer can be made to e.g. about 50-500 µm. On the other hand, instead of the plating, on the tip part of the copper or copper alloymade base body, the iron-nickel alloy-made coating member: (bulk material) can be used to constitute the iron-tip. Further, the iron-nickel alloy is composed of e.g. about 5-80 wt.% iron. Then, the tip material can be applied not only to the iron tip for soldering iron but also to a nozzle for solder sucking machine.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

Page 2 of 2

.. Searching PAJ

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(12) 公開特許公報(A) (19) 日本図格許介 (JP) (11)特許出限公開吞号 特開2000-317629 (P2000-317629A) (43)公開日 平成12年11月21日(2000.11.21) (51) Int.CL' 数别起母 FΙ テマロード (参考) B23K 3/02 B23K 3/02 J N P U 等性的水 未前水 流が頂の数7 OL (全 5 頁) 島経質に続く (71) 出頭人 000234339 (21)出翩番号 松留平11-128154 白光探式会社 (22)出窗日 平成11年5月10日(1999.5.10) 大阪府大阪市流速区塩草2丁目4谷5号 (72)発明者 上谷 季司 大阪府大阪市琅建区塩率2丁目4番5号 白光练式会社内 (74) 经联人 100095316 **非理士 福島 三雄 (外2名)** 

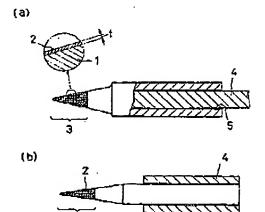
#### (54) 【発明の名称】 今日ごで用こて先

(57)【獎約】

(修正有)

【課題】 鉛フリー半田にも対応可能で、こて先の高温 酸化と、それに伴う半田の福れ経の不負を防止する半田 ごて用こて先の提供。

【解決手段】 網ないし銅合金級の基体の表面に、鉄ーニッケル合金メッキが施されてなることを特徴とする米田でて用こて光である。なお、この鉄ーニッケル合金メッキの皮原硬度は、マイクロビッカース硬度で約300以下である。また、前配合金メッキ県の原厚は、例えば約50~500μmとすることができる。一方、メッキの代わりに、銅ないし銅合金製の基体の先端部に、鉄ーニッケル合金製の鉄理部材(バルク付)を設けて構成してもよい。なお、解記鉄ーニッケル合金は、鉄が倒えば約6~80重量%とされてなる。ところで、米田でて用こて先のみならず、半田改い取り鉄用のノズルにも週月可能である。



(2)

核闘2000-317629

• . • •

#### 【特許請求の筋団】

【粛水項】】 とて先先端部の表面が、鉄ーニッケル台 金とされてなることを特徴とする半田とて用こて光。

1

【語水理2】 国ないし、割合金製の事体の表面に、鉄ー ニッケル合金メッキが施されてなることを特徴とする話 永順1に記載の半田ごで用とて先。

【館水理3】 前記鉄ーニッケル台金メッキは、皮質硬 度がマイクロビッカース硬度で約300以下であること を特徴とする調求項2に記載の半回じて用こて先。

00 mmとされてなることを特徴とする請求項2 又は請 求項3に記載の半因ごて用こて先。

[請求項5] 鋼ないし飼合会製の基体の先換率に、鉄 - ニッケル合金製の被要部計が設けられてなることを特 欲とする請求順1に記録の半田ごで用こて先。

【請求項6】 前記除ーニッケル合金は、除が約5~8 0 重霊%とされてなることを特徴とする請求項 1 から請 **象項§までのいずれかに記載の半图じて用こて先。** 

【記水項7】 記念項1から請求項6までのいずれかに 吸い取り微用のフズルとされてなることを特徴とする半 田敷い取り級用ノズル。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は 電気学田ごてのこ て先及び李函数取扱用のノズルに関し、特に、ピフリー 学田にも交通なく使用できる新規な半田ごで用こて先及 び半田吸取設用ノズルに関するものである。

【従来の技術】半田ごてのこて先は「芒蝗側の発熱部の」的「なり、半田が届れなくなったときも寿命となる。 熱エネルギーを先起側の半田付け作業部分に伝える働き をする。このため、こて先に使用される崇材《華体》に は、熱伝導性の食い材料が使用されなければならない。 しから、とて光光線部の半田付け作業部分は、半田付け 作業がし易いように、孝田が濡れる付賀である必要があ る。従って、半囲ごてのこて先には、熱伝棒候が高く、 半田温れ性のよい材料が使用されなければならない。

[0003] このようなことから、こて先には、従来よ り劉(意敬素銅)タフピッチ組、統削劉、錦台金を含 む)が一般的に使用されている。但し、銅は半田橋れ後(40) が良い代わりに、半田による摩耗が激しいので、銅にエ っケルメッキ又は鉄メッキを飽されることが多いのが栞

【りり()4】そして、李田とては、使用される半田に応 いててて先温度を設定して使用される。迎席、最も良い 些田付け温度は、半田の融点+約50°C程度とされてお り 半田ごてのこで先の温度は、作業性を良くするた め 更に約100℃前後高く設定されるのが普遍であ る.

が使用され、63%Sn-37%Pbの共晶半田が一般 的に使用されている。なお この63%Sn-37%P b共品学田の場合、その融点は183℃である。

【0008】しかし、最近になって半田の主要成分であ る館(Pb)が公路問題の対象として取り上げられるよ うになり、半田合金のPDフリー化が急速に進められる ようになった。それは東電製品や目動車等の廃棄物が不 **症投棄されて、内蔵部品であるブリント基板等から酸性** 南等の外的要因によりPbが溶け出して、地中に浸透 【臨水垣4】 前記台金メッキ屋の塔尾が、約50~5 10 し、地下水を汚染させることが、とくに米国で大きな社 会問題として取り上げられ 世界中でPりフリーが呼ば ねる様になったからである。・

【0007】との種のPbフリーの半田として、例え は 桃郷 (Sn) や、鍋-競(Sn-Ag) 共晶半田 や、蛭一銀一銅(Sn-A8-Cu)共尾半田等、値々 のものが関発されている。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記鉛 フリー半田は、その融声が従来の63%Sn=37%P 記載の半囲ごて用こて先において、とのこて先は、孝田 20 b半田に比べ高い。例えば、韓Spの融点は约232℃ であり、また、SnrAg-Cu系の融点は約210~ 230℃である。このため、Pbフリー半田を使用する 場合には、作業温度を高くする必要があり、350℃以 上に上げないと十分な半田付け性が得られない。ところ が、高温環境下での使用では、こて先が微化して展ずみ 易く、添れ性が悪くなり。 半田付けの作業性を悪化させ る問題があった。つきり、とて先の寿命は、通常、顧益 体上のニッケルメッキや鉄メッキが侵食され、書体の領 まで半田が優入した時とされるが、こて先作業部が黒く

> 【①①①9】また、Pカフリー半田の特徴として、添れ 修 拡がり修が共晶半田に比べて悪いことが、こて先の 酸化を加速させている。これは、例えば次のようにし て、超こる。すなわち、作業時にこて先のクリーニング として、こて先をスポンジ等でぬぐうことがあるが、こ の時、こて先の表面から大部分の半田が一緒に除去され ている。そして、共阜半田の場合は、次に半田を設った 時に、また新しい半田でこて先を覆うことができるが、 Pbプリー半田の頃合は、一部分しか半田がまわらない ため、半田の入れ替わりが起こらず、半田で採われてい ない部分は、やがて下途の鉄メッキ部分が募出して壁化 したり、フラックスが焼け付いて炭化したりするのであ る。通常、こて先の学田メッキ部分は、寂われた半田に よって、熱の伝導を良くしているので、濡れ性がなくな れば、とて先に遺られた半田は球状になって着しく作業 他が悪くなったり、作类できなくなったりする。

【①010】なお、フラックスは、半田付けを行うとき には、不可欠なものであり、糸半田の場合、ロジン(松 やに)に少量の活性剤を添加したものが使用されてい 【0005】一方、半田としては、通常、錦と鉛の合金・50 る。ロジンの主収分であるアピエチン酸は、高温では不 (3)

特別2000-317629

活性であるが170℃以上で活性となる。また、ブラッ クスの活性範囲の上版は、研究の結果、約350°Cであ るととが分かってきた。つまり、約3.50 T以上で学田 付けすると、ブラックスの効果が減少したり、炭化して こて先に焼き付いてしまうのである。

【りり】1】一般的に使用されている第一鉛の共晶半段 の場合は、前記活性範囲で半座付けすることができる。 が、融点の高い半田を使ったり、こて先温度を400℃ 以上に設定して作業した場合には、境付きが起こり易 Pb-Ag-Sa朶 (融点約309℃) の高温半田や、 前記記レス半田では、焼き付きが起こり易い。

【0012】このように、紐レス半田では、資来の縄-鉛共晶学田に比べて、半田温れ性や鉱がり性が悪く、銅 製芸体の表面に鉄メッキを経した従来の半因とてでは、 鉛ブリー半個には対応できず、数回の半田付け作業しか できなかった。

【りり13】この発明は「上記事情に鑑みてなされたも のであり、その主たる目的は、単田こて先が約350℃ 以上の作業環境においても、ヤニ入り単田合金(特にフー26 【0020】とのように「一般的には、半田満れ性と半 ラックス)の劣化による揺れ候及び近がり性の悪化を抑 制すると共に、独領ないし制合金製のとて先の高温酸化 を名抑制して、比較的長期間に残って良好な半田付け作 ②を可能とする半因じて用して先を提供することにある。 る。そして、これにより、PDフリー半田にも十分対応 可能な半因ごで用こて先を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の半田ごで用とて先は、とて先先総部の表面 が、鉄ーニッケル合金とされてなることを特徴とする。 30 じとなってしまう。 具体的には、例えば、銅ないし銅合金製の基体の表面 に、鉄ーニッケル台会メッキが飽されてなることを特徴 とする米田ごて用こて先である。なお、この鉄ーニック ル合金メッキの皮膜硬度は、マイクロビッカース硬度で 約300以下である。また、前記合金メッキ層の程序 は、例えば約5 0~5 0 0 μ m とすることができる。― 方、メッキの代わりに、銅ないし銅合全製の基件の先擔 部に 鉄ーニッケル台金製の被覆部付 (バルク村)を設 けて構成してもよい。なお「丽記鉄ーニッケル合金は、 鉄が倒えば約5~80室室%とされてなる。ところで、 本発明は、半田ごて用こて先のみならず、半田殿い取り 級用のノズルにも適用可能である。

[0015]

【発明の実施の形態】この発明の学田ごて用こて先は、 こて先先繼部の表面が、映一ニッケル合金とされてな る。鉄ーニッケル合意とした理由は、以下のとおりであ

【りり16】図3は、名金銭が学田に侵食される愛を測 定したグラフである。具体的には、一定量の糸半田をこ て先に送ったときのこて先の優有量を示しており、議論 50 【りり26】ところで、発熱体々は、こて先の内部に設

は一般的に使用されること先温度帯とし、こて先温度の 変化による侵食量の創定結果を示している。

【0017】この図より明らかなとおり、いずれの金属 においても、こて先退度が高くなる程、侵食量が多くな り、また半田の高れ性が食い材料程、侵食量が多くなる ことが分かる。

【3018】半田の謎れ性は、その全属の結晶構造、最 面状態(配化皮膜の出来長さ)、金属の純度、金属の領 度等、従うの芸匠から決まってくるが、一番大きな要因 い。よって、Sn-Sn系(融点235~240℃)や 15 は半田の銀との金属陶化合物の出来易さによるものと考 えられる。

> 【10119】鉄の場合、その金属間化合物は、低温域で はFeSn。であるが、約400℃以上の高温域になると、 FeShに変化し始め、特に4.5.0 で以上になると、その変 化が飽きになる。この現象は、図3からも読み取れる。 鉄の使食登は、こて先収度が400℃を越えると増加し 始め、450℃を境に急激に増加している。また。頭や 金等は、代食量が鉄・ニッケルに比べ、100倍近くあ り、侵食というより、溶解ということができる。

> **昭耐侵食性は、祖友する関係にある。ところが、鉄ーニ** ッケル合金 (四示例では帙5.8%合金) の場合、耐侵食 性(侵食量)は鉄とほぼ同じであるのに、半田温れ性は 鉄よりも良いという興味深い結果が得られた。錦との金 周間化合物の生成過程で、純金層にはない現象が起こっ ていることに起因するものと思われる。

> 【0021】なお、銅基体にニッケルメッキしたこで先 は、半田濡れ性が改書されるが、鉄メッキしたこで先と 比べて、侵食量が約20倍となるので、労命が約1/2

> 【①①22】このようなことから、本発明では、銅基体 に鉄ーニッケル合金部分を設けたこで先を開発するに至 ~たものである。

100231

【実施例】以下 本契明の半田ごて用こて先について、 度に詳細に説明する。図1は、本発明の学田ごで用こで 先の一葉旋例の概略構造を示す鉄面図である。

【① 024】この発明のとて先は、銅ないし網合金を呑 体】としており、少なくとも先継側の半田付け作業部分 49 3に、半田濡れ性の食い鉄ーニッケルメッキの反駁2が **いけられている**.

【0025】との実施例のこて先は、基礎側が搭款に形 成される一方。先婚側は、先婦側に行くに従って先細と なる略円錐形状に形成されている。そして、このとて先 は、発験体々によって加熱されて使用される。つまり、 こて先先端部の半田付け作業部分3は、こて先の毎路側 に設けられた発酵体 4 からの熱を熱圧薬によって使えれ て加熱される。なお、発動体4としては、例えばセラミ ックヒーターが使用される。

(4)

けることもできるし、こて先の外国部に配置してもよ い。つまり、図1 (a) に示すように こて先基礎部に 基端面に期回して桑森体整込穴5を形成し、その差込穴 5に、こて先の基礎部から発急体4を差し込んで こて 先を内側から加熱する構成としてもよい。 吹いは同図 (b) に示すように、こて先の基準側の外周部に異称体 4 を配置して、こて先を外側から加熱する機械としても Les.

【0027】鉄ーニッケルメッキは、こて先の外周部会 3だけに施してもよい。なお、通常、半田付け作業部分 3以外の箇所には、岸圏協れ性のない表面処理 同えば クロムメッキを誑している。

【0028】鉄・ニッケル合金皮膜をは、マイクロビッ カース観度日マ=3()(は以下の歌らかいもので 原廷性 がよく、衰菌酸化胆の除去が比較的容易である。との皮 順は、福度第一鉄(200~300g/!)をベースに した光沢剤等の有酸化合物をほとんど使用しないメッキ 浴で得られる。

重に設定されるが、例えば、鉄が約5~80重量%、好 ましくは約10~80重量%、更に好ましくは10~6 () 重量%程度とされる。

【①030】また、鉄ーニッケル合金メッキ圏2の層層 1は、行に関わないが、余りに厚くすると、熱任調性が 悪くなることを考慮して、例えば約1~1000gm。 好ましくは約50~500μm、更に好ましくは約10 ○~5○○μの程度に改定される。

【① 631】なお、メッキは、通常、選択で行われる が 厚さ的数A~数um程度のイオンプレーティング や 厚さ約)μm~lmm程度の密射等の乾式でメッキ することも可能である。

【0032】ところで、こて先先巡部に鉄ーニッケルメ っキを施すことによらず、こて先先端部に、鉄ーニッケ ル合金製の被援部材6をロウ付け又は圧振等によって一 体的に固者してもよい。例えば、図2 (a) に示すよう に、とて先先端部を検辞面に形成し、その傾斜面に沿っ て鉄-ニッケル合金のバルク材61をロク付け又は圧接

してもよい。また、同図(b)に示すように、こて先先 鎮部を取付きの略用鉄台形状とし、その先端部に略三角 盆形状のバルク付62をキャップ状にログ付け又は圧扱 して取り付ける等してもよい。

【0033】上記各案施例では、この発明を半田どての こて先に適用した例について説明したが、本発明は、半 田吸い取り機用のノズルにも適用可能である。すなわ ち、半田吸取機の吸取ノズルの先端部の裏面に、鉄ーニ っケル台途メッキを施したり、吹いは鉄=ニッケル台金 体に超してもよいが、こて先先絶命の半田付け作業部分 10 製のパルク材を口う付け又は圧接して取り付けて帰成す る。そして、そのノズルをヒーターで加熱しつつ、ノズ ル先端を除去すべき半田に当てて徳融させ、寝融半田を 其空ポンプで吸引するのである。鉄ーニッケル合金メッ キを結ずことで、Pカフリーの半田の吸い取り除去に好 速に使用することができる。

#### [0034]

【発明の効果】以上詳述したとおり、この発明の半田ご て用こて先によれば、350℃以上の比較的高い作業温 度でも、良好な半円付けを比較的長期間に健って実現可 【0029】なお、統・ニッケル合金の組成割合も、適 20 能である。よって、比較的融点が高い鉛フリー半田にも 十分対応可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

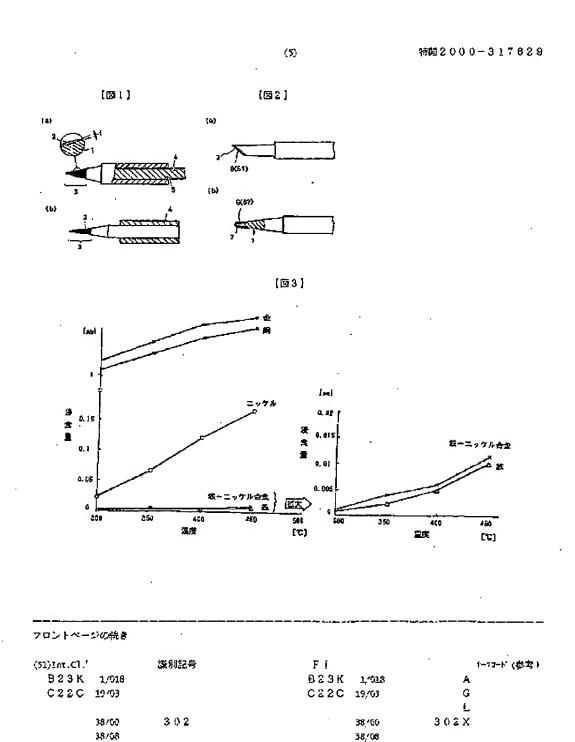
【図1】本発明の半田ごで用こで先の一美絶例を示す図 である。

【図2】 本発明の楽田ごて用こて先の他の実施例を示す 図である。

【図3】各金属が半円に侵食される量を測定したグラフ である。

【符号の設明】

- 30 ) 五体
  - 2 鉄ーニッケル台会部分(鉄ーニッケル台金度験等)
  - 3 半田付け作業部分
  - 4 异脉体
  - 5 是然体是达穴
  - 8 鉄ーニッケル台会材
  - 61 パルク紡(彼疑部付)
  - 62 バルク钎(綾羅部計)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.